

レーザー、ハロゲンランプなどの
はんだ付けに対応!

ポイントはんだ付け材料

Developed for laser and halogen lamp soldering methods! Point Soldering material

COMPATIBLE WITH
DISPENSING METHOD + POINT SOLDERING

LSM SERIES



特長
Feature

• はんだボール抑制
Less solder ball occurrence

• 安定した吐出性
Stable dispensing performance

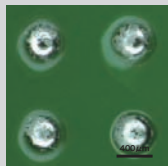
• 洗浄性良好
Good washability

• ノンハロゲン対応
Non-halogen

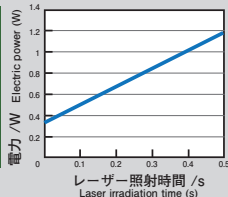
溶融性 Solderability

LSM10-204-02

粘度:80Pa s 粒径:20-36 μ m Viscosity:80Pa s
Particle size:20-36 μ m
Sn-3.0Ag-0.5Cu (融点220°C) Sn-3.0Ag-0.5Cu (m.p.: 220°C)



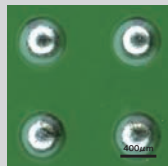
未溶融・未凝集なし
Good solderability



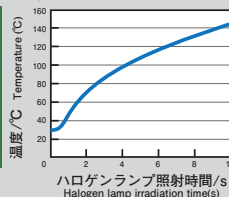
低融点タイプ

LSM10-401-02W-TR1

粘度:100Pa s 粒径:25-45 μ m Viscosity:100Pa s
Particle size:25-45 μ m
Sn-58Bi (融点138°C) Sn-58Bi (m.p.:138°C)

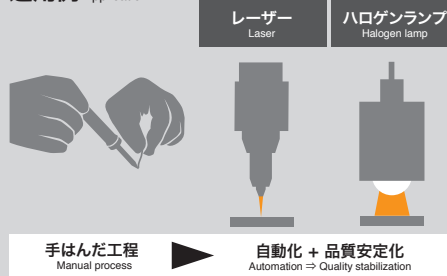


未溶融・未凝集なし
Good solderability



開発品
Under development

適用例 Application



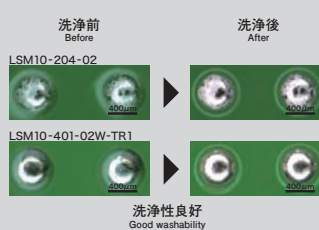
吐出性 Dispensing performance

対応可能ノズル内径 Applicable inner nozzle diameter	0.40 ϕ	0.35 ϕ	0.30 ϕ
LSM10-204-02	○	○	○
LSM10-401-02W-TR1	○	○	—
連続吐出性 (LSM10-401-02W-TR1) Dispensing performance	初期 Initial	12h 8,000 shot	24h 16,000 shot
塗布径 (μ m) Application diameter (μ m)	360	360	350
塗布量 (mg) Application quantity (mg)	0.03	0.03	0.03

安定した吐出性
Stable dispensing performance

連続吐出ディスペンス条件 Dispensing condition	
基板 Substrate	銅板Copper board (50×50×0.5)
ノズル内径 (mm ϕ) Nozzle inside diameter	0.35
シリンジ温度 (°C) Syringe temperature	25
クリアランス (mm) Clearance	0.15

洗浄性 Washability



洗浄条件 Cleaning condition	
洗浄液 Cleaning detergent	準水系/炭化水素系 Quasi water / Hydrocarbon
温度 Temperature	50°C
洗浄方法 Cleaning method	超音波洗浄 Ultrasonic
洗浄時間 Dwell time	10 min